

プリント基板向け直接描画装置の高解像性モデルを開発

株式会社SCREEN PE ソリューションズはこのほど、5G関連やIoTインフラを中心に急速に需要が拡大しているHDI（高密度多層）基板やパッケージ基板などの高精細なパターン形成に対応する、プリント基板向け直接描画装置「Ledia 7F」を開発。2021年10月から販売を開始します。



Ledia 7F

☆この画像の印刷用データ（解像度300dpi）は、
下記URLよりダウンロードできます。
(www.screen.co.jp/about/nr-photo_2021)

近年、5G対応スマートフォンやタブレット、車載・産業機器を中心としたIoTインフラの急速な普及に伴い、これらの電子機器に搭載されるプリント基板の需要が拡大しています。一方、小型化・高密度化が進むHDI基板およびパッケージ基板においては、従来以上に微細なパターン形成が不可欠となることから、プリント基板業界では、高精細な描画性と高生産性を両立できる直接描画装置へのニーズが高まっています。

このような動向を背景に当社は、プリント基板向け直接描画装置として全世界で累計600台以上の導入実績を持ち、ソルダーレジスト^{※1}向けとして業界のデファクトスタンダードとなっている「Lediaシリーズ」の最新機種となる、「Ledia 7F」を開発しました。この装置は、実績と先進性を備えた従来機種^{※2}を進化させ、描画位置精度をさらに向上させるとともに、露光部の機構を刷新。露光面のスポットサイズを30%^{※3}小径化することで、ハイエンドパッケージ基板のソルダーマスク露光に対応しています。また、データ送りピッチの高分解能化によって、斜めラインや曲線のより滑らかな描画が可能となり、メタルマスクや電子部品といった高アスペクト比のパターン形成用途にも対応するなど、汎用性の高い装置となっています。

当社は、今回の「Lediaシリーズ」のラインアップ拡充により、5G関連やIoTインフラを中心に拡大が続くHDI・パッケージ基板市場へのビジネス展開を加速させるとともに、今後もプリント基板業界のさまざまなニーズに応え、同業界の発展に貢献していきます。

※1 ソルダーレジスト：プリント基板の表面を覆う絶縁保護膜のこと。

※2 当社製「Ledia 6F」

※3 当社従来製品比

● 本件についてのお問い合わせ先

株式会社SCREEN PE ソリューションズ 営業統轄部 営業部 マーケティング課 Tel: 075-417-2704 pe-info@screen.co.jp